

# 浙江晶盛机电股份有限公司

## 关于与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司

### 签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次签订的战略合作协议属于三方合作的框架性协议，协议中具体事宜或未尽事项各方仍将另行签订具体的合作协议予以明确。
- 本次签订的战略合作协议不会对公司2017年经营业绩产生重大影响。

#### 一、协议的基本情况

##### 1、协议签订的基本情况

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）致力促进无锡集成电路产业链的发展优化，就共同在宜兴市开展建设集成电路用大硅片生产与制造达成合作事宜，于2017年10月12日在江苏省无锡市签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。

##### 2、协议对方的基本情况

（1）江苏省无锡市人民政府

（2）天津中环半导体股份有限公司

法定代表人：沈浩平

注册资本：264,423.6466 万元

主营业务：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术

的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中环股份为 A 股上市公司（股票代码：002129），公司与中环股份不存在关联关系。

### 3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于授权经营层签署合作事项相关文件的议案》，同意并授权经营层与无锡市人民政府、中环股份签署合作事项相关文件，并组织合作项目的实施。协议的具体事宜或未尽事项，公司仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

## 二、协议的主要内容

### 1、合作目的及愿景

各方基于对贯彻落实《中国制造 2025》和《国家集成电路产业发展推进纲要》的总体部署的一致认识，发挥各自优势，整合各方资源，共同在无锡推动建设和发展半导体材料研发制造基地，为我国集成电路产业发展作出应有的贡献，同时促进无锡市经济社会发展和中环股份、晶盛机电企业综合竞争力提升，实现互利共赢。

### 2、合作主要内容

（1）无锡市人民政府全力支持中环股份、晶盛机电来无锡发展和投资，在无锡和宜兴提供符合中环股份、晶盛机电需求的生产制造、生产配套、科研办公、生活用地。

（2）中环股份、晶盛机电协同无锡市人民政府下属的投资平台公司或产业基金确定项目投资主体，共同在宜兴市启动建设集成电路用大硅片生产与制造项目（以下简称“集成电路大硅片项目”），以市场需求为导向，规划和分期建设，项目总投资约 30 亿美元，一期投资约 15 亿美元。

（3）无锡市人民政府将集成电路大硅片项目列入无锡市重大产业项目，开设行政审批绿色通道，在选址用地、项目环评、税收优惠、投融资、科技研发、人

才引进、项目推进机制等方面给予最便利的办事流程、最全面的服务保障、最优惠的政策支持，尽快创造满足项目开工的各项条件。

合作三方达成共同意向，本协议的签署不排除今后在本协议所拟合作范围内同其他方的合作。

### 三、对公司的影响

1、本次战略合作符合《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造2025》的政策方向,抓住了全球集成电路产业向中国加速转移的市场机遇，各方将共同推动集成电路用大硅片项目的启动建设和健康发展，有利于提升我国半导体材料行业的水平，缓解半导体材料供应对中国半导体产业发展的制约，促进我国电子信息产业的发展。

2、本次与中环股份的合作，是继国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之《区熔硅单晶产业化技术与国产设备研制》合作之后的再一次在半导体领域的深度合作，将发挥公司在半导体设备研发制造领域的优势，有利于公司保持半导体硅晶体生长设备的技术先进性和市场领先优势，大力推进半导体关键设备国产化，不断提升公司半导体设备核心竞争力。

3、本次战略合作符合公司“新材料、新装备”战略规划，依托公司晶体生长设备研发与制造优势，协同合作方建设国际先进的集成电路大硅片研发和生产基地，实现合作方互利共赢，有利于促进公司综合竞争力提升，推动公司长期可持续发展。

4、本次合作事宜不会对公司2017年经营业绩产生重大影响。

### 四、风险提示

1、本次签订的战略合作协议属于三方合作的框架性协议，协议中具体事宜或未尽事项各方仍将另行签订具体的合作协议予以明确；

2、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、截止本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议的进展如下：

| 协议名称             | 协议签订方                 | 披露日期       | 进展情况                                   |
|------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|
| 《战略合作框架协议》       | 浙江大学机械工程学院、晶盛机电       | 2015年1月9日  | 根据协议建立了机电装备创新研究院，研究生创新实践基地、教育基金也在正常实施中 |
| 《半导体硅材料产业战略合作协议》 | 北京有色金属研究总院、中环股份、晶盛机电  | 2015年5月26日 | 对相关资产进行了审计和评估，尚未取得实质性进展                |
| 《战略合作协议》         | 杭州海康威视数字技术股份有限公司、晶盛机电 | 2016年9月7日  | 根据协议进行了智能车间物流系统等项目的合作                  |

4、公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司所持公司股份已经全流通，不存在未来三个月其限售股解除限售的情况；截止本公告披露日，公司未收到控股股东或持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

## 五、备查文件

《无锡市人民政府&天津中环半导体股份有限公司&浙江晶盛机电股份有限公司战略合作协议》

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2017年10月13日